

NEP230

ノンシリコンニ液型熱伝導ダイアタッチ材

LiPOLY NEP230 は、低分子量シロキサンを蒸発させない、シリコンフリーの2成分液状シーラントです。粘度が高く、接着性に優れているため、室温または高温で素早く硬化できます。3.0 W/m*Kの熱伝導率を持つ NEP230 は、高い熱伝導率と低い熱抵抗を備えています。自動ディスペンサー装置またはハンドフィーダーでのディスペンスに最適です。

■ 製品の特性

- / 熱伝導率：3.0 W/m*K
- / ディスペンサーで塗布可能
- / 常温または熱硬化材料
- / 組み立て時の低応力で作業可能
- / 金属およびPCBへの優れた接着性

■ 製品アプリケーション

- / 電子部品: 集積回路、中央処理装置
トランジスタ、マザーボード
ワイヤレス ネットワーク シェアラー
電気通信機器、自動車用電子機器
コンピューターおよび周辺機器
- / 発熱部品とヒートシンクの間
- / 5Gの基地局(基幹施設/設備)
- / 電気自動車

■ 容量の単位

- / カートリッジ：50ml, 400ml
- / 客特注容量も対応できます。

■ 保存期間

- / 当製品が未使用の状態、室温30度の条件には24ヶ月が保存できます。(製品は長期保管すると、オイルと粉が分離する場合があります。これはオイルと粉の密度差により沈殿する物理現象であり、製品自身の性能には影響がなく、ご使用いただけます。当製品を使用前に均一に攪拌することをお勧めします。)

■ 代表特性

物理特性	NEP230	試験方法	単位
色	Black Gray (A part) Black (B part)	Visual	-
主成分	Epoxy	-	-
A:B	100:100	-	-
粘度 A	253	ISO 3219	Pa.s
粘度 B	250	ISO 3219	Pa.s
チキソトロピー指数	2.9	ISO 3219	-
密度	2.8	ASTM D792	g/cm ³
使用温度	-40~120	-	°C
表面硬化	25°C / 1.5 hr	By LiPOLY	-
硬化条件1	25°C / 3.5 hr	By LiPOLY	-
硬化条件2	40°C / 1.5 hr	By LiPOLY	-
硬化条件3	60°C / 30 min	By LiPOLY	-
硬化条件4	80°C / 10 min	By LiPOLY	-
硬さ	90	ASTM D2240	Shore A
破断時伸び率	<1	ISO527	%
引張強さ	60	ISO527	N/cm ²
アルミへのラップせん断強度	300	ASTM D1002	N/cm ²
保存期間	60 months	-	-
ROHS & REACH	Compliant	-	-
電気特性			
絶縁破壊電圧	14	ASTM D149	KV/mm
体積抵抗率	>10 ¹¹	ASTM D257	Ohm-m
熱特性			
熱伝導率	3.0	ISO 22007-2	W/m*K

